



Elektrotechnik, Elektronik

und

Elektromagnetische Verträglichkeit

Übersicht

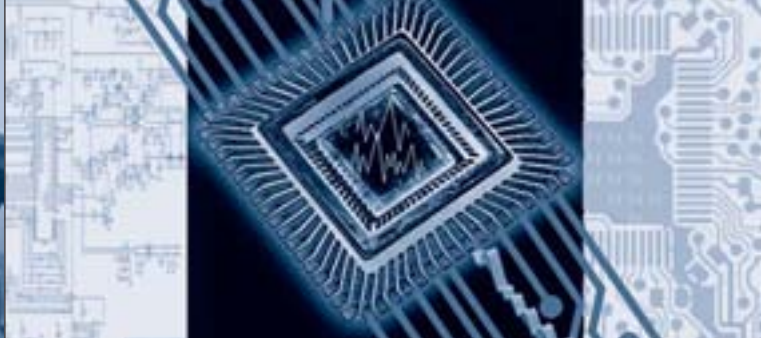
Februar 2010 bis Oktober 2010



Training
Seminare
Tagungen



Bildnachweis: Impressum Project-Fotos



Von Profis für Profis

- **Namhafte Experten aus Industrie und Wissenschaft sind Ihre Referenten.**
- **Profitieren Sie von der praxisnahen, anwenderfreundlichen und herstellerneutralen Wissensvermittlung.**
- **Die Veranstaltungen werden ständig weiterentwickelt – wir garantieren Ihnen so ein Höchstmaß an Qualität und Aktualität.**
- **Sie lernen zukunftsweisende Technologien und neue Verfahren kennen, die Sie in Ihrem Unternehmen umsetzen können.**
- **Mit dem präsentierten Technischen Know-how können Sie Ihre Produkte optimieren und sich so Wettbewerbsvorteile verschaffen.**
- **In meist nur zwei Tagen werden die Inhalte übersichtlich und kompakt dargestellt – Sie sparen dadurch Zeit und Kosten.**
- **Sie knüpfen neue Kontakte und besprechen Ihre Fachfragen mit Experten und Kollegen aus anderen Unternehmen.**
- **Zu den Fachforen erhalten Sie zur schriftlichen Dokumentation auch die Vorträge auf CD.**
- **Das Rahmenprogramm am Abend des ersten Tages sorgt für die besondere Atmosphäre und fördert den Erfahrungsaustausch.**

So urteilen die Teilnehmer

„Sehr informative Veranstaltung, gute Vorträge, gute Location und sehr schönes Rahmenprogramm. War sehr zufrieden. Gute Unterlagen!“

Friedemann Riethmüller, Service-Elektroniker, Robert Bosch GmbH, Reutlingen, Mai 2009

Dieses Seminar ist für den Anwender von wiederaufladbaren Batterien und den Entwicklern von batteriegespeisten Geräten sehr zu empfehlen.

Dipl.-Ing. (FH) Martin Rüttel, Produktentwicklung, Johnson Matthey Catalysts Germany GmbH, Redwitz, Mai 2009

Gutes Grundlagenseminar, sehr gut um in die Materie einzusteigen.
Matthias Härtl, Projektingenieur, SCHOTT Rohrglas GmbH, April 2009

EMV-konformes Leiterplatten- und IC-Design in der Entwicklung (EML)

Inhalt

- EMV-Leiterplatten-Design
- EMV-Anwendungen passiver Bauelemente
- High-Speed-Leiterplatten-Design
- Lagenaufbau / Lagendefinition
- Emission und Störfestigkeit von integrierten Schaltkreisen
- Praktische Beispiele und Live-Simulation mit Freeware Tools

Fachliche Leitung

Hartwig Reindl
Leiter EMC Engineering Automotive Quality Labs,
Continental Automotive GmbH, Regensburg

Teilnehmerkreis

- Ingenieure und Techniker im Bereich Hardwareentwicklung, Leiterplatten- oder EMV-Design
- Layouter und Entwickler für elektronische Baugruppen mit erhöhten Anforderungen an EMV- und High-Speed-Anwendungen

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

Ihre Termine

08. bis 09. Februar 2010 in Regensburg
01. bis 02. Dezember 2010 in Regensburg

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung



Bildnachweis: Werkbild b-plus gmbH

Messunsicherheit in Mess- und Prüfprozessen (PMF)

Inhalt

Proseminar Prüfmittelüberwachung (1/2-tägig)

- Stand der Normen und Richtlinien
- Planen, Beschaffen und Verwalten von Mess- und Prüfmitteln
- Gebrauch, Lagern und Aussondern von Messmitteln
- Wirtschaftliche Umsetzung, Organisations- und Entscheidungsprozesse

Seminar Messunsicherheit in Mess- und Prüfprozessen (2-tägig)

- Gesetzliche und vertragliche Forderungen
- Bestimmungen der Messunsicherheit nach GUM (Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement – DIN V ENV 13005)
- Berechnung der Messunsicherheit
- Aufstellen des Messunsicherheitsbudgets
- Nachweis der Verwendbarkeit und der Eignung der Prüfprozesse
- Optimieren der Prüfprozesse

Fachliche Leitung

Prof. Dr.-Ing. Benno Kotterba
Fachhochschule Heidelberg und Geschäftsführer der md-pro GmbH,
Karlsruhe

Teilnehmerkreis

- Verantwortliche und Mitarbeiter aus den Bereichen Qualitätssicherung, Entwicklung, Konstruktion, Fertigungsplanung und Arbeitsvorbereitung
- Auditoren und QM-Beauftragte
- Mitarbeiter von Ingenieurbüros und beratenden Unternehmen

Teilnahmegebühr

Proseminar und Seminar (2 1/2-tägig)

Pro Person: € 1280,00

Seminar: (2-tägig)

Pro Person: € 1060,00

Ihre Termine

08. bis 10. Februar 2010 in Regensburg

04. bis 06. Oktober 2010 in Regensburg

MAX. TEILNEHMERZAHL
20 Personen

Ethernet im industriellen Einsatz – Grundlagen, Protokolle und Anbindung eigener Geräte (ETA)

Inhalt

- Industrieller Einsatz von Ethernet
- Übertragungssicherheit und Echtzeitaspekte
- Standardisierungsaktivitäten wie EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINet, IAONA etc.
- Wesentliche Protokolle im Detail (IP, TCP, UDP, DHCP, PPP)
- Embedded Web-Server und ihre Protokolle (HTTP, FTP, SMTP, POP3, HTML, XML)
- PC-Programmierung auf Basis Socket-Schnittstellen
- Anbindung eigener Geräte (Chips, Controller, Firmware-Stacks)
- Praktische Vorführungen:
Über Ethernet angekoppelte Messsysteme und Analysator-Software

Fachliche Leitung

Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus Fertigungs-, Verfahrens- und Umwelttechnik, Lebensmittelproduktion, Maschinenbau, Kfz-Industrie
- Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Produktion und Marketing
- Entwicklungs- und Produktmanager
- Mitarbeiter aus Ingenieurbüros und Softwarehäusern
- Fachleute aus Universitäten und Fachhochschulen
- Systemadministratoren industrieller Netzwerke

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 1060,00

OTTI Mitglieder: € 1010,00

MAX. TEILNEHMERZAHL
24 Personen

Ihr Termin

01. bis 02. März 2010 in Regensburg



Fraunhofer IZM



Gedruckte Elektronik - dünn, flexibel, kostengünstig (GET)

Inhalt

- Aktivitäten, Entwicklungen, Herausforderungen
- Materialien und Formulierungen
 - organische Polymere
 - anorganische Nanopartikel
- Substrate und Verkapselung
- Druckverfahren – etablierte Techniken und Neuentwicklungen
- Komponenten, Systemintegration, Hybridtechnologien
- Aktuelle und potenzielle Anwendungsfelder
 - Sensoren
 - Displays
 - Beleuchtung
 - Energieversorgung
- Perspektiven, Trends, Marktprognosen

Fachliche Leitung

Dr. Peer Löbmann
Senior Scientist, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg

Teilnehmerkreis

- Entwicklungsleiter, Produktionsleiter, Fach- und Führungskräfte der Elektronikindustrie, die sich für den Einsatz von Low-Cost-Elektronik und Massen-Produkten interessieren
- Hersteller und Entwickler von elektronischen Materialien, Druckfarben, Substraten und Druckereitechnik
- Entwickler, Konstrukteure und Ingenieure der Verpackungs-, Kommunikations-, Display- und Photovoltaikindustrie, der Medizintechnik sowie der Textil- und Spielwarenbranche
- Fach- und Führungskräfte aus Produktion, Logistik und Marketing

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

08. bis 09. März 2010 in Regensburg

Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen (SEB)

Grundlagen – Technologien – Projektbeispiele

Inhalt

- Zuverlässigkeit von Baugruppen bei unbekannter Klimabelastung
- Schadensmechanismus und Simulation
- Zuverlässigkeit unter wechselnden Klimabedingungen
- Flussmittelrückstände kritisch bewertet
- Notwendige Voraussetzungen für Klimaschutz
- Schutzwirkung von Lacken und Verguss
- Auswirkung auf die Lötstellen

Fachliche Leitung

Dipl.-Ing. Karl Ring
ZVE Zentrum für Verbindungstechnik in der Elektronik des Fraunhofer IZM, Oberpfaffenhofen-Weßling

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus Produktion, Arbeitsvorbereitung/Technologie, Konstruktion, Entwicklung und Qualitätsmanagement der Elektronik- und Elektrotechnikindustrie
- Mitarbeiter der Leiterplattenindustrie und Baugruppen-Fertigung
- Ingenieure, Techniker, Chemiker und Materialwissenschaftler aus dem Gebiet der Lackier- und Beschichtungstechnik

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

24. bis 25. März 2010 in Regensburg



Bildnachweis: EPCOS AG, München

Leiterplattendesign fertigungsgerecht – wirtschaftlich – innovativ (LPD)

Inhalt

- Grundlagen für Einsteiger
- Der Prozess vom Schaltungsträger (Leiterplatte) bis zur kompletten elektronischen Flachbaugruppe bzw. zu Modulen nach neuesten wirtschaftlichen und technologischen Erkenntnissen (RoHS-Konformität)
- Layoutgestaltung, Konstruktion sowie High-Speed Design
- Technologische Trends bei RoHS-konformen Bauelementen und Leiterplatten
- EMV-Design in der Elektronik
- Fertigungsgerechtes Leiterplattenlayout
- Unterschiedliche Fertigungs- und Prüftechniken

Fachliche Leitung

Dr.-Ing. Udo Bechtloff

Geschäftsführer KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, die sich mit der Entwicklung/Konstruktion bzw. Fertigung und Prüfung von elektronischen Flachbaugruppen/Modulen befassen
- Verantwortliche und Mitarbeiter aus Entwicklung, Konstruktion, Technologie, Fertigung, Prüfung und Qualitätssicherung

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00

OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

14. bis 15. April 2010 in Regensburg

Geräte EMV-konform entwickeln (EMS)

Inhalt

- Grundlagen und Aktuelles zu Gesetzen und Normen: EMV-Richtlinie, EMV-Gesetz, Normung
- EMV-gerechte Auslegung von Schaltungen
- EMV-Bauelemente, Gehäuseschirmung und Transientenschutz
- Praktische Vorführungen (Messtechnik, Gerätedesign)
- Vorgehensweise bei der Entstörung von Geräten
- Spezielle Aspekte bei EMV-Messungen
- Erfolgreiche Vorgehensweisen in der Praxis

Fachliche Leitung

Dipl.-Ing. Wolfgang Sammet

Leiter Development & Application, EPCOS AG, Heidenheim

Teilnehmerkreis

- Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Applikation und Prüftechnik von elektrischen und elektronischen Geräten
- Unternehmen der Industrie und Unterhaltungselektronik sowie Haushaltsgeräte- und Elektrowerkzeughersteller

Teilnahmegebühr

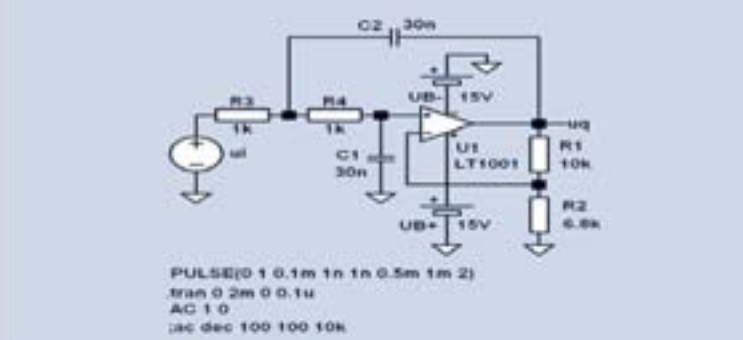
Pro Person: € 960,00

OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

14. bis 15. April 2010 in Regensburg



Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen (ESD)

Inhalt

- Interner und externer ESD Schutz
- Ursachen der Elektrostatik
- Praktische Hinweise zum ESD-Test von Bausteinen und Baugruppen (System Level ESD)
- Aufbau und Überprüfung von ESD-Schutzzonen und Fertigungsanlagen
- Stand der Normung (inkl. der neuen DIN EN 61340-5-1)
- Messtechnik in der Praxis
- Neueste Trends in der ESD-Welt (Industry Council on ESD target values)

Fachliche Leitung

Dipl.-Phys. Reinhold Gärtner
Senior Principal for ESD Protection, Infineon Technologies AG,
München

Teilnehmerkreis

- Techniker und Ingenieure aus Entwicklung, Fertigung und Prüftechnik der Elektronikindustrie und der Zulieferbetriebe für die Kfz-Industrie
- Mitarbeiter im Qualitätsmanagement

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

26. bis 27. April 2010 in Regensburg

SPICE – Einführung in die Schaltungssimulation (SIT)

Inhalt

- Bedeutung und Leistungsmerkmale der Schaltungssimulation innerhalb moderner Entwicklungsprozesse
- Übersicht Simulationswerkzeuge
- SPICE-Simulatoren (LTSPICE, PSPICE): Gemeinsame Merkmale, Unterschiede, Transfer von Netzlisten
- SPICE, Grundlagen, Schaltplanerstellung, Modelle, Analysearten, Resultatdarstellung, Anwendungen
- EMV-Analyse mit SPICE
- LTSPICE (freeware) – Simulationsübungen am PC

Fachliche Leitung

Prof. Dr.-Ing. Dieter Anke
ehemals Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Hochschule für angewandte Wissenschaft (FH) Regensburg

Prof. Dr.-Ing. Dr. Techn. Laszlo Palotas
ehemals Fachgebiet Übertragungstechnik und Netzwerktheorie, FB ING Ingenieurwissenschaften, SB Informationstechnologie und Elektrotechnik, Hochschule Rhein-Main

Teilnehmerkreis

- Techniker, Ingenieure, Schaltungsentwickler und Halbleiterhersteller aus
- der Elektrotechnik
 - der Mechatronik
 - der Kfz-Elektronik

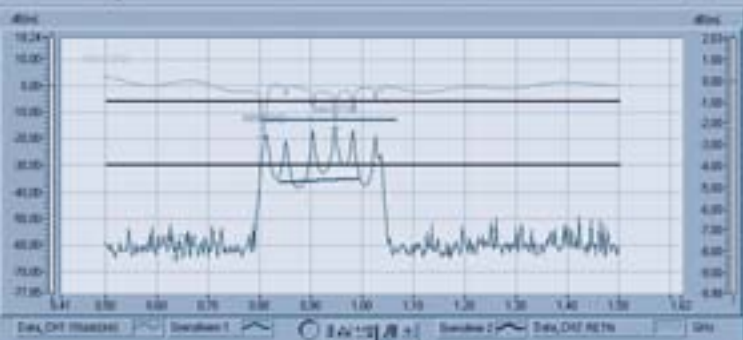
Teilnahmegebühr

Pro Person: € 1250,00
OTTI Mitglieder: € 1200,00

MAX. TEILNEHMERZAHL
24 Personen

Ihre Termine

28. bis 29. April 2010 in Regensburg
13. bis 14. Oktober 2010 in Regensburg



ZSW Baden-Württemberg, Lithium-Ionen Batterie (40Ah/24V)

Prozessdaten erfassen, übertragen und auswerten – ein Überblick für Einsteiger und Entscheider (MEA)

Modul 1: Industrielle Bussysteme in der Praxis – Produktion, Prüffeld und Labor

- Einsatzebenen industrieller Kommunikation in produzierenden Unternehmen
- Von der Messwertdigitalisierung bis zur Datenübertragung per Bussystem
- Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen - der Basis-Anschluss im industriellen Umfeld
- Klassische Feldbusse - Kommunikations-Standards in der Produktion
- Industrial Ethernet - Fortgeschrittene Kommunikation in der Produktion
- Laborbusse - Standards für Prüffeld und Labor

Modul 2: Messdatenerfassung und -auswertung – Hard- und Softwareaspekte

- Grundlagen der Messwertdigitalisierung
- PC-basierte Hardware-Architekturen für die Messtechnik
- Standardisierte Software-Schnittstellen am PC
- Standardverfahren der Messdatenauswertung
- Fallstudie: Programmieren von Messapplikationen mit LabVIEW

Fachliche Leitung

Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg

Teilnehmerkreis

- Technische Führungskräfte aus Produktion, Prüffeld, Labor und Entwicklung unter anderem in folgenden Branchen: Elektrotechnik/Elektronik, Maschinenbau, Kfz-Industrie, Verfahrens- und Umwelttechnik, Lebensmittelproduktion etc.
- Technisch orientierte Mitarbeiter in Vertrieb, Produktmanagement, Marketing und Einkauf
- Projektleiter in Engineering-Unternehmen, Ingenieurbüros und Behörden

Teilnahmegebühr

Beide Module:
Pro Person: € 1060,00

Einzelmodul:
Pro Person: € 680,00

MAX. TEILNEHMERZAHL
24 Personen

Ihr Termin

03. bis 04. Mai 2010 in Regensburg

Wiederaufladbare Batteriesysteme (ABS)

Inhalt

- Übersicht und detaillierte Beschreibung ausgewählter Batterietechnologien und Supercaps
- Lebensdauer (Einflussfaktoren, Optimierung)
- Lademethoden und Batteriemangement
- Sicherheit
- Entwicklungstendenzen in den Bereichen Automotiv- und Gerätebatterien sowie stationäre Batterien
- Möglichkeit zur Besichtigung des ZSW, Ulm

Fachliche Leitung

Dr. Andreas Jossen
Geschäftsbereich Energiespeicherung und Energieumwandlung,
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
(ZSW Baden-Württemberg), Ulm

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Vertrieb und Service
- Hersteller von Batteriesystemen
- Planer, Ingenieure und Techniker aus allen Bereichen, in denen Batterien angewendet werden, z. B. Telekommunikation, Computertechnik, Konsumgeräte, Regenerative Energiesysteme, Automobiltechnik
- Energieversorgungsunternehmen/Stadtwerke

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 1020,00
OTTI Mitglieder: € 970,00

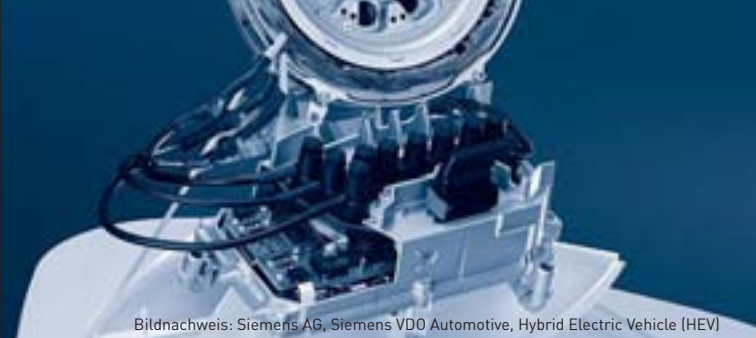
FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

05. bis 06. Mai 2010 in Ulm



Continental Automotive GmbH, Regensburg



Bildnachweis: Siemens AG, Siemens VDO Automotive, Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Automobilelektronik EMV-konform entwickeln (EMB)

Inhalt

- Grundlagen und Aktuelles zu Gesetzen und Normen: EMV-Richtlinie, EMV-Gesetz, Normung
- Entwicklungsverlauf und Design-Regeln
- EMV-Messungen an den Komponenten und am Gesamtfahrzeug
- Fehleranalyse, Messergebnisse, Auswirkungen auf das Design
- Zusammenspiel und Wechselwirkung zwischen Automobilhersteller und Zulieferer
- FreigabeprozEDUREN bis zur Serienreife
- Neue Trends in der automobilen EMV-Welt
- Messpraxis live erleben bei der Continental Automotive AG

Fachliche Leitung

Dipl.-Ing. Uwe Birnbaum
PEMC/ Volkswagen AG, Wolfsburg
Dipl.-Ing. Norbert Hensengerth
Continental Automotive GmbH, Regensburg

Teilnehmerkreis

- Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Konstruktion, Qualitätssicherung und Fertigung sowie Mitglieder des mittleren Managements aus den Bereichen Einkauf und Vertrieb
- Entwickler mit Ausrichtung auf die EMV-Mess- und Prüftechnik
- Die Messdemonstrationen sind insbesondere für Techniker und Ingenieure, welche neu in einem EMV-Labor eingesetzt werden sollen oder sich zusätzlich mit Messungen befassen wollen

Teilnahmegebühr

Fachforum und Messdemonstrationen

Pro Person: € 1290,00

Nur Fachforum

Pro Person: € 960,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

05. bis 07. Mai 2010 in Regensburg

Leistungselektronik in der Automobiltechnik (LIA)

Inhalt

- Überblick über moderne Leistungselektronik-Anwendungen im KFZ
- Entwurf und Analyse von Wandlerkonzepten
- Passive Elemente: Filter und Speicher
- Aktive Elemente: moderne Halbleiterschalter – Diode, PowerMOSFET, IGBT
- Konstruktive Aspekte, Temperaturmanagement, Lebensdauer
- Anwendungen: Energieerzeugung und -verteilung, Stellglieder
- Energiespeicherung und alternative Energiequellen
- Elektromagnetische Verträglichkeit

Fachliche Leitung

Prof. Dr.-Ing. Dieter Anke
ehemals Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Hochschule für angewandte Wissenschaft (FH) Regensburg

Teilnehmerkreis

- Ingenieure aus Projektierung, Entwicklung, Konstruktion, Prüftechnik, Fertigung, Applikation und Vertrieb
- Technische Verwaltung mit Entscheidungskompetenz

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 1290,00

OTTI Mitglieder: € 1240,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

09. bis 11. Juni 2010 in Regensburg



Bildnachweis: Joachim Bös

Entwicklung geräuscharmer Geräte (EGG)

Inhalt

- Psychoakustik und Sound Design
- Schallentstehungsmechanismen
- Geräuschanalyse und -bewertung
- Ableitung von Lärminderungsmaßnahmen
- Akustische Mess- und Auswerteverfahren
- Einsatz numerischer Simulationswerkzeuge
- Lärmarme Lüfter und leise Hausgeräte
- Lärminderung an Maschinen und Anlagen

Fachliche Leitung

Dr.-Ing. Joachim Bös

Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik SzM,
Technische Universität Darmstadt, und Fraunhofer-Institut für Betriebs-
festigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF, Darmstadt

Teilnehmerkreis

- Akustikingenieure, Mitarbeiter aus dem Bereich der technischen Geräusch- und Schwingungsminderung
- Konstrukteure, Produktentwickler und Produktionsleiter
- Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau, aus der Elektronik und Elektrotechnik
- Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Produktion, Qualität und Marketing
- Entwicklungs- und Produktmanager

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

14. bis 15. Juni 2010 in Regensburg



Bildnachweis: WEVO-CHEMIE GmbH, Ostfildern

Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik (VER)

Inhalt

- Anwendungsbereiche und Notwendigkeit des Vergießens
- Übersicht über Vergussmaterialien
- Einsatzpotenzial unterschiedlichster Vergussmaterialien
- Neuere Entwicklungen bei Materialien und Applikationstechnik
- Dosiertechnik von Vergussmaterialien
- Numerische Strömungssimulation
- Anwendungsbeispiele aus Elektronik und Elektrotechnik
- Arbeitsschutz

Fachliche Leitung

Priv. Doz. Dr. Andreas Hartwig

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte
Materialforschung IFAM, Bremen

Teilnehmerkreis

- Ingenieure, Techniker, Chemiker und Materialwissenschaftler aus dem Gebiet der Vergussmaterialien und deren Anwendung
- Entwickler, Anwendungstechniker und leitende Produktionsmitarbeiter aus der Elektronik- und Elektrotechnikindustrie

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

16. bis 17. Juni 2010 in Regensburg



Bildnachweis: EPOCS AG

Wirtschaftlichkeit von EMV-/ESD-Aufwendungen im Unternehmen (ESE)

Inhalt

14. Juni 2010 ab 19:00 Uhr

Einstimmungsgespräch mit Dr. Ulrik Gollob, Gollob Rechtsanwälte Steuerberater, München bei einem gemeinsamen Abendessen: „Haftung und Notwendigkeit von EMV-/ESD-Aufwendungen im Unternehmen“

15. Juni 2010

EMV und ESD sind wichtige Themen bei der Produktqualifikation und Anwendung im Feld. Sind jedoch teure EMV-ESD-Maßnahmen wirklich für alle Produkte immer sinnvoll und nötig?

- Zeit- und kostensparende Strategien und Vorgehensweisen
- Gegenüberstellung best case – worst case
- Analyse von Fehlerquellen
- Darstellung der Handlungsmöglichkeiten (Wo Wann Was)
 - Vermeidungsstrategien
 - Konsequenzen eines Felddausfalles
 - Kosten und Wirtschaftlichkeit

Fachliche Leitung

Dipl.-Phys. Reinhold Gärtner

Senior Principal for ESD Protection, Infineon Technologies AG, München

Hartwig Reindl

Leiter EMC Engineering Automotive Quality Labs,
Continental Automotive GmbH, Regensburg

Teilnehmerkreis

- Unternehmer, Geschäftsführer, Technische Leiter, Entwicklungsleiter, CEOs und CFOs aus kleinen und mittleren Unternehmen
- Fach- und Führungskräfte aus der Elektronik/Elektrotechnik-, Elektromechanik, Automotivebranche, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, dem Maschinen- und Anlagenbau und aus allen Bereichen von sicherheitsrelevanten Produkten

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 630,00
OTTI Mitglieder: € 580,00

MAX. TEILNEHMERZAHL
20 Personen

Ihr Termin

15. Juni 2010 in Regensburg
mit Einstimmungsgespräch am 14. Juni 2010 ab 19:00 Uhr

Elektromagnetische Verträglichkeit – Grundlagen (EMG)

Inhalt

- EMV-Einsatzbedingungen
- Leitungs- und feldgebundene Kopplungswege
- Simulation
- EMV-gerechte Vorgehensweise bei Konstruktion und Design
- Messtechnik von Emission und Störfestigkeit
- Gesetzliche und normative Vorgaben
- Ausgewählte EMV-Beispiele aus Theorie und Praxis

Fachliche Leitung

Prof. Dr.-Ing. Dieter Anke

ehemals Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Hochschule für angewandte Wissenschaft (FH) Regensburg

Prof. Dr.-Ing. Marco Leone

Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektromagnetischen Verträglichkeit, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Teilnehmerkreis

- Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Konstruktion, Prüftechnik, Fertigung, Applikation und Vertrieb
- Technische Verwaltung mit Richtlinienkompetenz
- Projektierung

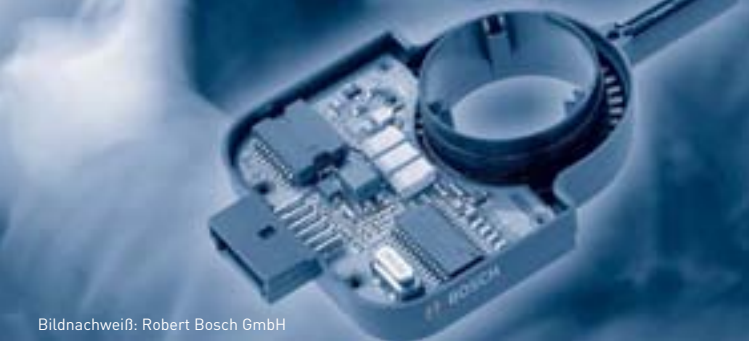
Teilnahmegebühr

Pro Person: € 1290,00
OTTI Mitglieder: € 1240,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

13. bis 15. September 2010 in Regensburg



Bildnachweiß: Robert Bosch GmbH



PolyIC GmbH & Co. KG

Kunststoffe in der Elektronik (KUT)

Inhalt

- Eigenschaften von Kunststoffen
- Materialanforderungen
- Flammschutz & Additivierung
- Kunststoffverarbeitung in der Elektronik (Spritzguss, Klebtechnik, Metallisieren)
- 3D-MID
- Neue Trends & Innovationen auf dem Kunststoffsektor
- Anwendungsbeispiele aus Elektronik und Elektrotechnik
- Polytronic

Fachliche Leitung

Dr.-Ing. Carsten Weiß
Senior Manager, Corporate Sector Research and Advance Engineering,
Robert Bosch GmbH, Waiblingen

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte, Ingenieure und Entwickler, die sich mit Kunststoffen in der Elektronik befassen
- Physiker, Chemiker und Materialwissenschaftler

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

15. bis 16. September 2010 in Regensburg

RFID – aktuelle Anwendungen und Zukunftsperspektiven (RID)

Inhalt

- Marktübersicht
- Grundlegende Techniken und Standards
- RFID - Hard- und Software
- RFID – Systemlösungen
- Neuere Technologien
- Heutige und zukünftige Anwendungen
- In der Praxis auftretende Probleme
- Der Umgang mit kritischen Stimmen im eigenen Unternehmen
- Zukunftsperspektiven
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Fachliche Leitung

Wolfgang Mildner
Managing Director, PolyIC GmbH & Co. KG, Fürth

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen und Institutionen, die sich für RFID interessieren (Produzierende Industrie, Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie und Gesundheitswesen)
- Mitarbeiter von Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Materialwirtschaft, Handel und Logistik

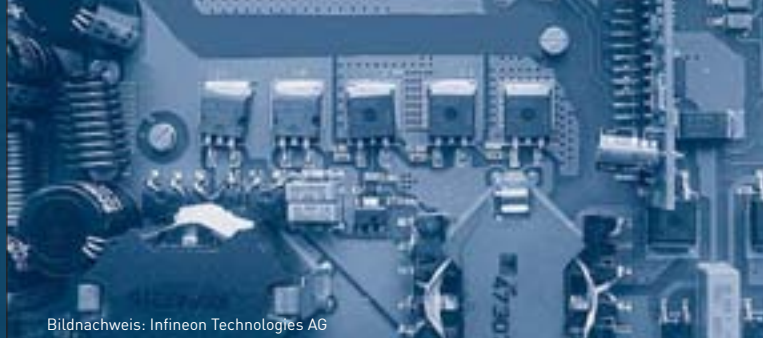
Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

20. bis 21. September 2010 in Regensburg



Bildnachweis: Infineon Technologies AG

Elektrisch leitfähige Kunststoffe – Eigenschaften, Prüfung, Anwendung (ELK)

Inhalt

- Marktübersicht, Produkte, Herstellungsverfahren für leitfähige Kunststoff-Compounds
- Vergleich etablierter leitfähiger Füllstoffe
- Leitfähige Lackierungen und UHV-Beschichtungen
- Neuartige leitfähige Füllstoffe
- Elektrostatische Zündquellen mit Experimental-Vorführung
- Überblick über die Gesetze und Normen zu EMV und ESD
- Kunststoffgehäuse zur Abschirmung elektromagnetischer Wellen
- Antistatisch ausgerüstete Kunststoffgehäuse und Verpackungen
- Besichtigung des EMV-Labors der Continental Automotive GmbH, Regensburg

Fachliche Leitung

Dr. Bernhard Pfeiffer
Global OEM Manager, Ticona GmbH, Kelsterbach,
ein Unternehmen der Celanese AG.

Teilnehmerkreis

- Werkstofffachleute
- Ingenieure und Physiker in Entwicklung, Konstruktion, Fertigungsvorbereitung und Prüffeld der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, der chemischen Industrie und den Zulieferbetrieben für Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie dem Maschinen- und Bergbau

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

23. bis 24. September 2010 in Regensburg

Getaktete Stromversorgungen (GSV)

Inhalt

- Vorteile getakteter Stromversorgungen/Schaltnetzteile
- Vor- und Nachteile verschiedener Wandlerstrukturen
- Auswahl und Dimensionierung aktiver und passiver Bauelemente
- Auslegung der Ansteuerung
- Konstruktive Gestaltung, Aspekte elektrischer Sicherheit
- Simulation getakteter Stromversorgung
- Anforderung EMV-Gesetz, Störgrößenemission und Störfestigkeit, Prüfverfahren

Fachliche Leitung

Prof. Dr.-Ing. Dieter Anke
ehemals Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Hochschule für
angewandte Wissenschaft (FH) Regensburg

Teilnehmerkreis

- Ingenieure, Techniker und Projektierer aus Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Applikation und Vertrieb

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 1290,00
OTTI Mitglieder: € 1240,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihre Termine

04. bis 06. Oktober 2010 in Regensburg



Bildnachweis: Fraunhofer-Institut IOF, Jena

Kleben in der Mikrofertigung – Klebstoffe, Präzisionsmontage, Qualitätssicherung (DQS)

Inhalt

- Kleben und Dosieren in der Mikro-Optik, Feinwerk- und Medizintechnik
- Klebstoff-Klassen und Härtungstypen
- Klebstoffauswahl und Verarbeitung
- Fertigungstechnik zum Kleben
- Montagetechnik für Präzisionsfertigung
- Prüftechniken und Qualitätssicherung
- Technische und wirtschaftliche Vorteile des Klebens

Fachliche Leitung

Dr. rer. nat. Thomas Gesang
Leiter Fertigungstechnologie und Klebtechnik für Mikrosysteme und
Medizinanwendungen, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus der Entwicklung, Produktion und dem Qualitätsmanagement der Mikro-Optik, Mikro-Elektronik, Feinwerk- und Medizintechnik und Mikrofluidik
- Ingenieure, Techniker, Chemiker und Materialwissenschaftler aus dem Gebiet der Klebstoffe und Vergussharze und deren Anwendungen

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

05. bis 06. Oktober 2010 in Regensburg



Wärmemanagement in elektronischen Systemen Kühlkonzepte für Leistungsbauteile, Baugruppen und Geräte (KEP)

Inhalt

- Grundlagen Wärmetransport: Kühlmechanismen in der Elektronik
- Leiterplatten- und Baugruppen-Design für Hochleistungsanwendungen
- Materialauswahl und Zuverlässigkeit in der Hochleistungselektronik
- Geräteentwicklung in der Kfz-, Kommunikations- und Medizintechnik
- Anwendung und Auswahl von thermischen Interface-Materialien
- Thermosimulation und Thermografie an Baugruppen, Systemen und Gehäusen
- Aktuelle Lösungsansätze für thermische Herausforderungen

Fachliche Leitung

Dr. Christoph Lehnberger
Leitung Technischer Vertrieb, ANDUS Electronic GmbH, Berlin

Teilnehmerkreis

- Entwickler, Konstrukteure, Ingenieure und Physiker aus den Bereichen
- Elektronikentwicklung
 - Systementwicklung
 - Strategische Planung
 - Vorausentwicklung

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

11. bis 12. Oktober 2010 in Regensburg



Selektivlöten ERSA Versaflow Miniwelle



Moderne Baugruppenproduktion – flexibel und wirtschaftlich bei höchster Qualität (SMT)

Inhalt

- Übersicht über die Leiterplattentechnologien und deren Oberflächen
- Auftrag und Materialeigenschaften von Lotpasten, moderne Lötverfahren
- Praxisberichte aus der Fertigung – vom Praktiker für den Anwender
- Trends bei den Verbindungstechnologien
- Moderne Reinigungsverfahren und Verarbeitung von Schutzlacken
- Neue Entwicklungen bei den automatischen Inspektionen (AOI, AXI)
- Qualitätsbeurteilung und Testmethoden zur Analyse der Zuverlässigkeit von Baugruppen
- ESD-Risiken und Vermeidung von ESD-Schäden

Fachliche Leitung

Dipl.-Ing. (FH) Joachim Krause
BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Neuching

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen und Instituten, die sich mit neuen Baugruppenkonzepten befassen
- Verantwortliche und Mitarbeiter aus Entwicklung, Konstruktion, Technologie, Fertigung und Qualitätssicherung
- Unternehmen, die neue wettbewerbsfähige Produkte entwickeln möchten

Teilnahmegebühr

Pro Person: € 960,00
OTTI Mitglieder: € 910,00

FRÜHBUCHERBONUS
bis 8 Wochen vor Veranstaltung

Ihr Termin

20. bis 21. Oktober 2010 in Regensburg

Weitere OTTI-Veranstaltungen im Bereich Technik

- Biopolymere: Möglichkeiten nutzen – Zukunft gestalten (BIK)** 01. bis 02. Februar 2010
- So stellen Sie Ihre Stromversorgung sicher- Schutzmaßnahmen und Lösungswege aus und für Industrie und Dienstleistung (GES)** 03. bis 04. März 2010
- Instandhaltung heute und morgen - Wertschöpfung für die sichere und wirtschaftliche Produktion (INS)** 22. bis 23. März 2010
- Metallkorrosion - eine vermeidbare Materialzerstörung? (KOS)** 19. bis 20. April 2010
- 8. Symposium Zukunft Glas – von der Tradition zum High-Tech-Produkt (GLS)** 21. bis 22. April 2010
- Fügetechnik Kleben - Neuere Technologien, Verarbeitungstechnik und Anwendungen (KLE)** 26. bis 28. April 2010
- Technische und hochtemperaturbeständige Thermoplaste, Blends und Nanocomposites (HPA)** 17. bis 18. Mai 2010
- Implantate - Materialien, Beschichtungen und Anwendungen (MED)** 19. bis 20. Mai 2010
- Kosteneinsparpotenziale Druckluft (DRU)** 19. bis 20. Mai 2010
- Der Facility Manager seine Tools, Methoden und Konzepte(FAM)** 14. bis 15. Juni 2010
- Erfolgreich disponieren und beschaffen (EDI)** 22. bis 23. Juni 2010

Ihre Ansprechpartner

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.



Dipl.-Päd.
Ilona Lamour
Bereichsleiterin
Technik

Telefon +49 941 29688-25
Telefax +49 941 29688-31
E-Mail: ilona.lamour@ottti.de



Dipl.-Phys.
Helmut Reff
Seminar-
manager

Telefon +49 941 29688-34
Telefax +49 941 29688-31
E-Mail: helmut.reff@ottti.de

Ich melde mich für folgende Veranstaltungen verbindlich an

Veranstaltungstitel oder Kürzel/Datum

Bitte senden Sie mir ausführliche Programme zu folgenden Veranstaltungen zu

Veranstaltungstitel oder Kürzel/Datum

Name

Vorname

Titel

Telefon

Telefax

E-Mail

Abteilung/Funktionsbereich

Firma/Institution

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Rechnungsadresse (nur bei Abweichung von der Anmeldeadresse)

Firma/Institution

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Branche

Zahl der Mitarbeiter

OTTI-Kundennummer

Datum

Unterschrift

**Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI),
Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg**

Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen. Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstaltungseinlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei OTTI eingegangen ist. Etwaige Änderungen aus dringendem Anlass behält sich OTTI vor. Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 bis 15 Tagen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 120,00. Bei späteren Absagen (ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. Für Sach- und Vermögensschäden, welche OTTI zu vertreten hat, haftet OTTI – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg.